

XXX 有限公司

新一代高端半导体芯片研发项目

可
行
性
研
究
报
告

编制工程师：中投信德杨刚

目 录

第一章 总 论	1
1.1 项目概要	1
1.1.1 项目名称	1
1.1.2 项目建设单位	1
1.1.3 项目建设性质	1
1.1.4 项目建设地点	1
1.1.5 项目负责人	1
1.1.6 项目投资规模	1
1.1.7 项目建设规模	2
1.1.8 项目资金来源	2
1.1.9 项目建设期限	2
1.2 项目建设单位介绍	3
1.3 编制依据	3
1.4 编制原则	4
1.5 研究范围	4
1.6 主要经济技术指标	5
1.7 综合评价	6
第二章 项目市场分析	7
2.1 建设地经济发展概况	7
2.2 我国新一代高端半导体芯片研发行业发展状况分析	7
2.3 我国新一代高端半导体芯片研发行业发展趋势分析	8
2.4 市场小结	9
第三章 项目建设的背景和必要性	10
3.1 项目提出背景	10
3.2 项目建设必要性分析	11
3.2.1 有利于促进我国新一代高端半导体芯片研发工业快速发展的需要	11
3.2.2 提升技术进步，满足新一代高端半导体芯片研发行业生产高品质产品的需要	12
3.2.3 符合现行产业政策及清洁生产要求	13
3.2.4 提升我国新一代高端半导体芯片研发产品研发和技术创新水平的需要	13
3.2.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要	13
3.2.6 增加当地就业带动产业链发展的需要	14
3.3 项目建设可行性分析	14
3.3.1 政策可行性	14
3.3.2 技术可行性	15
3.3.3 管理可行性	16
3.4 分析结论	16

第四章 项目建设条件	17
4.1 地理位置选择	17
4.2 区域投资环境	17
4.2.1 区域位置概况	17
4.2.2 区域地形地貌条件	18
4.2.3 区域气候条件	18
4.2.4 区域交通区位条件	19
4.2.5 区域经济发展条件	19
第五章 总体建设方案	21
5.1 总图布置原则	21
5.2 土建方案	21
5.2.1 总体规划方案	21
5.2.2 土建工程方案	22
5.3 主要建设内容	23
5.4 工程管线布置方案	23
5.4.1 给排水	23
5.4.2 供电	25
5.5 道路设计	27
5.6 总图运输方案	28
5.7 土地利用情况	28
5.7.1 项目用地规划选址	28
5.7.2 用地规模及用地类型	28
第六章 产品方案及技术方	30
6.1 主要产品方案	30
6.2 产品质量指标	30
6.3 产品价格制定原则	30
6.4 产品生产规模确定	30
6.5 项目生产工艺简述	31
6.5.1 产品工艺方案选择	31
6.5.2 工艺技术流程及简述	31
第七章 原料供应及设备选型	32
7.1 主要原材料供应	32
7.2 主要设备选型	32
7.2.1 设备选型原则	32
7.2.2 主要设备明细	33
第八章 节约能源方案	34

8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范	34
8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析	34
8.2.1 能源消耗种类	34
8.2.2 能源消耗数量分析	34
8.3 项目所在地能源供应状况分析	35
8.4 主要能耗指标及分析	35
8.5 节能措施和节能效果分析	36
8.5.1 工业节能	36
8.5.2 节水措施	37
8.5.3 建筑节能	37
8.5.4 企业节能管理	38
8.6 结论	39
第九章 环境保护与消防措施	40
9.1 设计依据及原则	40
9.1.1 环境保护设计依据	40
9.1.2 设计原则	40
9.2 建设地环境条件	40
9.3 项目建设和生产对环境的影响	41
9.3.1 项目建设对环境的影响	41
9.3.2 项目生产过程产生的污染物	42
9.4 环境保护措施方案	42
9.4.1 项目建设期环保措施	42
9.4.2 项目运营期环保措施	43
9.5 绿化方案	44
9.6 消防措施	44
9.6.1 设计依据	44
9.6.2 防范措施	45
9.6.3 消防管理	46
9.6.4 消防措施的预期效果	46
第十章 劳动安全卫生	48
10.1 编制依据	48
10.2 概况	48
10.3 劳动安全	48
10.3.1 工程消防	48
10.3.2 防火防爆设计	49
10.3.3 电力	49
10.3.4 防静电防雷措施	49
10.4 劳动卫生	50
10.4.1 防暑降温	50
10.4.2 卫生	50
10.4.3 噪声	50

10.4.4 照明	50
10.4.5 个人防护	50
10.4.6 安全教育及防护	50
第十一章 企业组织机构与劳动定员	52
11.1 组织机构	52
11.2 劳动定员	52
11.3 人力资源管理	52
11.4 福利待遇	53
第十二章 项目实施规划	54
12.1 建设工期的规划	54
12.2 建设期	54
12.3 实施进度安排	54
第十三章 投资估算与资金筹措	56
13.1 投资估算依据	56
13.2 项目建设投资估算	56
13.3 流动资金估算	57
13.4 资金筹措	57
13.5 项目投资总额	57
13.6 资金使用和管理	60
第十四章 财务及经济评价	61
14.1 销售收入及成本费用估算	61
14.1.1 基本数据的确立	61
14.1.2 产品成本	62
14.1.3 平均产品利润	63
14.2 财务评价	63
14.2.1 项目投资回收期	63
14.2.2 项目投资利润率	63
14.2.3 不确定性分析	63
14.3 经济效益评价结论	67
第十五章 风险分析及规避	68
15.1 项目风险因素	68
15.1.1 不可抗力因素风险	68
15.1.2 市场风险	68
15.1.3 资金管理风险	68
15.2 风险规避对策	68
15.2.1 不可抗力因素风险规避对策	69

15.2.2 市场风险规避对策.....	69
15.2.3 资金管理风险规避对策.....	69
第十六章 结论与建议	70
16.1 结论	70
16.2 建议	70

新一代高端半导体芯片研发项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解！

第一章 总 论

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

新一代高端半导体芯片研发项目

1.1.2 项目建设单位

XXX 有限公司

1.1.3 项目建设性质

新建项目

1.1.4 项目建设地点

本项目建设地址是四川省内江市威远县

1.1.5 项目负责人

报告定制编写：中投信德杨刚工程师

1.1.6 项目投资规模

本项目总投资为 10000.00 万元，其中，建设投资为 8497.50 万元（土建工程为 2972.00 万元，设备及安装投资 4692.45 万元，土地费用 525.00 万元，其他费用为 141.85 万元，预备费 166.20 万元），建设期利息为 502.50 万元，铺底流动资金为 1000.00 万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值 80100.00 万元，计算期内年均销售收入 56070.00 万元，年均利润总额 3533.54 万元，年均净利润 2650.15 万元，年上缴税金及附加为 116.19 万元，年可上缴增值税 1161.91 万元，投资利润率 35.34%，投资利税率 48.12%，税后投资回收期（含建设期）5.45 年。

1.1.7 项目建设规模

本项目主要生产产品：新一代高端半导体芯片研发。

本项目总占地面积为 35 亩，总建筑面积 17850.00 平方米，详细内容见下表：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	层数
1、主要建筑工程	标准厂房	10500.00	10500.00	1
	辅助车间	700.00	700.00	1
	办公楼	600.00	3000.00	5
	宿舍楼	600.00	3000.00	5
	配电房	145.00	145.00	1
	门卫室	55.00	55.00	1
	其他配套用房	450.00	450.00	1
总计		13050.00	17850.00	
2、公共工程	道路硬化及停车场	7200.00	7200.00	
	绿化工程	2800.00	2800.00	

1.1.8 项目资金来源

本项目总投资资金人民币 10000.00 万元，资金来源为企业自筹 5000.00 万元、申请银行贷款 5000.00 万元。

1.1.9 项目建设期限

本项目工程建设的工期共计 3 年。

1.2 项目建设单位介绍

郑州***纺织有限公司成立于 2006 年 8 月，位于新郑市***大道，占地 433 亩，是在整体收购河南***集团郑州***纺织有限公司的基础上建立的现代化、高标准、规模庞大，集棉纺针纺织品的设计、制造、销售等为一体的大型港资纺织企业，总纺纱规模 30 多万锭，员工计划 2500 多人。

郑州***纺织有限公司使用国内最先进的纺织设备，其关键及精密设备、纺纱设备全部从世界一流的瑞士立达公司、德国赐来福公司进口。在设备管理上采用国内外最先进的生产网络管理系统，能实现全方位的设备实时监控和信息共享，保证了产品的质量和设备的效用最大化。

郑州***纺织有限公司纺织产品为各种纯棉、功能性纤维混纺、优质高支环锭纺及紧密纺精梳纱，高档细支转杯纺纱。环锭纺是在最良好的技术和环境条件下生产；紧密纺更是光洁好毛羽少、条干匀、强力高，属市场紧缺产品；转杯纺是国际最先进机型，向纺优质细支针织纱发展。这些产品在一定程度上满足了国内的高端棉纺精梳产品的空缺。

1.3 编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2. 《四川省内江市威远县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》；
4. 《新一代高端半导体芯片研发工业发展规划（2016-2020 年）》；
5. 《中国制造 2025》；

1. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
2. 《工业可行性研究编制手册》；
3. 《现代财务会计》；
4. 《工业投资项目评价与决策》；
5. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
6. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5 研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业

市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6 主要经济技术指标

主要经济技术指标汇总表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标		
1	达产年设计产能		
1.1	新一代高端半导体芯片研发	X/年	X0.00
2	总占地面积	亩	35.00
3	总建筑面积	m ²	17850.00
4	总投资资金，其中：	万元	10000.00
4.1	建筑工程费用	万元	2972.00
4.2	设备及安装费用	万元	4692.45
4.3	其他费用	万元	141.85
4.4	预备费用	万元	166.20
4.5	建设期利息	万元	502.50
4.6	铺底流动资金	万元	1000.00
二	主要数据		
1	正常达产年年产值	万元	80100.00
2	计算期内年均销售收入	万元	56070.00
3	年平均利润总额	万元	3533.54
4	年均净利润	万元	2650.15
5	年销售税金及附加	万元	116.19
6	年均增值税	万元	1161.91
7	年均所得税	万元	883.38
8	项目定员	人	260
9	建设期	年	3
三	主要评价指标		
1	项目投资利润率	%	35.34%
2	项目投资利税率	%	48.12%
3	税后财务内部收益率	%	29.96%
4	税前财务内部收益率	%	38.10%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元	12,888.67
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元	18,392.59

7	投资回收期(税后)含建设期	年	5.45
8	投资回收期(税前)含建设期	年	4.52
9	盈亏平衡点	%	35.10%

1.7 综合评价

本项目重点研究“新一代高端半导体芯片研发项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前新一代高端半导体芯片研发消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。

本项目建设符合国家产业政策，选址符合四川省内江市威远县规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。

项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国新一代高端半导体芯片研发产业升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。

第二章 项目市场分析

2.1 建设地经济发展概况

2016 年，实现地区生产总值（GDP）1406.58 亿元，比上年增长 8.2%。其中，第一产业增加值 153.27 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 809.42 亿元，增长 8.6%；第三产业增加值 443.89 亿元，增长 9.1%。第一产业增加值占 GDP 的比重为 10.9%，比上年下降 0.1 个百分点；第二产业增加值比重为 57.5%，下降 1.4 个百分点；第三产业增加值比重为 31.6%，上升 1.5 个百分点。三次产业分别拉动 GDP 增长 0.4、5.0 和 2.8 个百分点，对经济增长的贡献率分别为 5.1%、61.5% 和 33.4%。人均地区生产总值 43110 元，比上年增加 3137 元，增长 8.0%。

2.2 我国新一代高端半导体芯片研发行业发展状况分析

作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的新一代高端半导体芯片研发工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

尽管外部环境不断变化，中国新一代高端半导体芯片研发工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球新一代高端半导体芯片研发产业格局的进一步调整，我国新一代高端半导体芯片研发工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国新一代高端半导体芯片研发工业正处于由大而强的关键转型期。

当然随着“中国制造 2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国新一代高端半导体芯片研发行业在传统新一代高端半导体芯片研发

技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《新一代高端半导体芯片研发工业“十三五”发展规划》的发布，中国新一代高端半导体芯片研发行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。

新一代高端半导体芯片研发行业发展空间

从产业发展层面看，新一代高端半导体芯片研发工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造 2025”“互联网+”推动信息技术在新一代高端半导体芯片研发行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国新一代高端半导体芯片研发行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：

面对我国新一代高端半导体芯片研发工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国新一代高端半导体芯片研发工业加快向中高端迈进。

2.3 我国新一代高端半导体芯片研发行业发展趋势分析

技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。新一代高端半导体芯片研发行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快新一代高端半导体芯片研发先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国

新一代高端半导体芯片研发行业的结构调整，大大提高我国新一代高端半导体芯片研发工艺技术水平，提高我国新一代高端半导体芯片研发的技术含量和产品档次。ERP 企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快新一代高端半导体芯片研发企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。新一代高端半导体芯片研发行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。

2.4 市场小结

综上所述可以看出，我国新一代高端半导体芯片研发业及新一代高端半导体芯片研发产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动新一代高端半导体芯片研发市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。

第三章 项目建设的背景和必要性

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

3.1 项目提出背景

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，新一代高端半导体芯片研发行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外新一代高端半导体芯片研发市场的变化，政府大力推动并加快新一代高端半导体芯片研发工业转型升级，新一代高端半导体芯片研发产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，新一代高端半导体芯片研发市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国新一代高端半导体芯片研发行业发展较好的行业背景、新一代高端半导体芯片研发等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“新一代高端半导体芯片研发项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的新一代高端半导体芯片研发开发生产基地。本次项目的建设对于加快四川省内江市威远县新一代高端半导体芯片研发

行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

3.2 项目建设必要性分析

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

企业获得的利润情况。

企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

扩大生产能力，改变产品结构。

采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

3.2.1 有利于促进我国新一代高端半导体芯片研发工业快速发展的需要

新一代高端半导体芯片研发

工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。

随着现代新一代高端半导体芯片研发工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代新一代高端半导体芯片研发业生产的主要方向，以减少中国新一代高端半导体芯片研发品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的新一代高端半导体芯片研发设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使新一代高端半导体芯片研发品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的新一代高端半导体芯片研发加工技术和装备，促进我国新一代高端半导体芯片研发工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.2 提升技术进步，满足新一代高端半导体芯片研发行业生产高品质产品的需要

搞好新一代高端半导体芯片研发技术进步与产业升级对于新一代高端半导体芯片研发全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。四川省内江市威远县 XX 有限公司自成立以来一直从事新一代高端半导体芯片研发新一代高端半导体芯片研发的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国新一代高端半导体芯片研发尖端技术的空白，还可有效满足新一代高端半导体芯片研发行业生产高品质产品的需要。

从新一代高端半导体芯片研发企业来说，生产高端新一代高端半导体芯片研发既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是新一代高端半导体芯片研发企业“做精”的战略选择。随着

新一代高端半导体芯片研发行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对新一代高端半导体芯片研发的市场需求。

3.2.3 符合现行产业政策及清洁生产要求

本项目符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。

3.2.4 提升我国新一代高端半导体芯片研发产品研发和技术创新水平的需要

本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化新一代高端半导体芯片研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端新一代高端半导体芯片研发，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进四川省内江市威远县产业结构调整和经济转型升级，夯实全省新一代高端半导体芯片研发产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。

3.2.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来国内新一代高端半导体芯片研发行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“新一代高端半导体芯片研发项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对新一代高端半导体芯片研发进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大新一代高端半导体芯片研发的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.6 增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国新一代高端半导体芯片研发及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

3.3 项目建设可行性分析

3.3.1 政策可行性

国务院印发《中国制造 2025》中提出：

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、新一代高端半导体芯片研发等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术和效益。

《新一代高端半导体芯片研发工业发展规划（2016-2020 年）》提出：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造 2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成新一代高端半导体芯片研发强国。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

3.3.2 技术可行性

本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

3.3.3 管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

3.4 分析结论

本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第四章 项目建设条件

4.1 地理位置选择

本项目建设地址选定在四川省内江市威远县。

项目区域位置示意图



4.2 区域投资环境

4.2.1 区域位置概况

威远地处四川盆地南部，位于北纬 $28^{\circ}55'37'' \sim 29^{\circ}38'25''$ 、东经 $104^{\circ}02'57'' \sim 105^{\circ}16'11''$ 之间。东邻隆昌、泸县，南界江安、南溪、宜宾，西与犍为、井研毗邻，北靠威远、内江。幅员面积 4373.13km^2 。享“千年盐都”，“恐龙之乡”，“南国灯城”，“美食之府”之美誉。管理自流井、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺两县，为四川省辖地级市，自贡于 1990 年筹建汇东新区（自贡高新技术产业开发区）

），是四川省现有的五个国家级高新区之一。自贡也是四川省五个主城区面积超 100 平方公里，人口超 100 万的“双百”大城市之一。

4.2.2 区域地形地貌条件

乐山地处四川盆地向西南山地过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔 4288 米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔 307 米，相对高差 3981 米，平均海拔 500 米，乐山城区海拔 360 米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积 8530km²，占全市幅员面积的 66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地过渡地带。丘陵面积 2694km²，占乐山市幅员面积的 21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，是受缓慢上升长期剥蚀而形成的红色丘陵区。河谷平原面积 1603km²，占全市幅员面积的 12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。

4.2.3 区域气候条件

乐山在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬 29°附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长。年平均气温在 16.5~18.0 度之间，年平均无霜期长达 300 天以上，年平均霜日 4.2~9.4 天，年平均降雪日数仅 1.0~2.7 天，是水稻、小麦、油料、糖料、水果、棉花等农副产品的高产区。西南山区气候垂直差异明显，从山麓至山巅依次分布着中亚热带—暖温带—温带—寒温带的完整气候带，气候条件十分复杂，是地域内发展农业综合经营和立体农业的区域，是木材、茶叶、中药材等作物的主产区，也是宝贵的旅游资源。受季风影响和地形的抬升作用，气候湿润，雨量丰沛。绝大多数地区年平均降水量在 1000 毫米以上，峨眉山市达 1500 毫米以上，仅峨边

、金口河少于 1000 毫米以下，降水有季节性变迁，夏秋季雨量占全年的 80%左右，冬春季只占 20%，降水的年际差异较大，年最少降水量多在 900 毫米以下，部分地区年最多降水量达 2000 毫米以上。

4.2.4 区域交通区位条件

乐山是成都经济区核心圈层的重要枢纽城市、成渝经济区重要交通节点和港口城市。全年完成货物运输总量 12768 万吨，其中公路 12494 万吨、水路 274 万吨。

公路。全市公路总里程 11871.26 公里，等级公路 11147 公里，其中新增公路里程 145 公里。已建成成乐、乐宜、乐雅、乐自、仁沐新仁井试验段等 5 条高速公路，境内通车里程 235 公里。有国道 213 线、245 线、348 线和省道 103 线、213 线、215 线、307 线、308 线、309 线、310 线、311 线、401 线、428 线、429 线、430 线等 15 条普通国、省公路，境内里程 1298 公里。有农村公路里程 9844 公里，实现乡乡通油路（水泥路）、村村通公路。

铁路项目。成昆铁路贯穿全境，其中市内里程 161 公里，设有站点 16 个。成绵乐铁路客运专线乐山段长 42.6 公里，已开通运营。成贵铁路、成昆铁路复线、连乐铁路正加快建设。

水运。全市通航总里程 976 公里，其中等级航道 293 公里，货运船舶总运力达 10.12 万吨客（渡）船共有 9187 客座。岷江港航电枢纽开发进入实施阶段，犍为枢纽、龙溪口枢纽分别于 2015 年 12 月、2017 年 3 月正式开工建设。

航空

乐山市距成都双流机场 120 公里，全程高速公路，乐山城区设有售票站。4C 级旅游机场乐山机场在 2016 年开工建设。

4.2.5 区域经济发展条件

2016 年，实现地区生产总值（GDP）1406.58 亿元，比上年增长 8.2%。其中，第一产业增加值 153.27 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 809.42 亿元，增长 8.6%；第三产业增加值 443.89 亿元，增长 9.1%。第一产业增加值占 GDP 的比重为 10.9%，比上年下降 0.1 个百分点；第二产业增加值比重为 57.5%，下降 1.4 个百分点；第三产业增加值比重为 31.6%，上升 1.5 个百分点。三次产业分别拉动 GDP 增长 0.4、5.0 和 2.8 个百分点，对经济增长的贡献率分别为 5.1%、61.5% 和 33.4%。人均地区生产总值 43110 元，比上年增加 3137 元，增长 8.0%。

第五章 总体建设方案

5.1 总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

5.2 土建方案

5.2.1 总体规划方案

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

5.2.2 土建工程方案

本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；

屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

结构设计方案

①地基及基础

根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

②结构选型

根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间拟采用全钢结构。

③本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

④建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。

5.3 主要建设内容

本项目总占地面积为 35 亩，总建筑面积 17850.00 平方米，详细内容见下表：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	层数
1、主要建筑工程	标准厂房	10500.00	10500.00	1
	辅助车间	700.00	700.00	1
	办公楼	600.00	3000.00	5
	宿舍楼	600.00	3000.00	5
	配电房	145.00	145.00	1
	门卫室	55.00	55.00	1
	其他配套用房	450.00	450.00	1
总计		13050.00	17850.00	
2、公共工程	道路硬化及停车场	7200.00	7200.00	
	绿化工程	2800.00	2800.00	

5.4 工程管线布置方案

5.4.1 给排水

一、设计依据

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009 年版）

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范 [2014 年版]》GB50014-2006

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

二、给水设计

A、水源

本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径 DN150。

B、室内给水系统

生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用 PP-R 给水管，热熔连接。

消防给水系统

设有室内消火栓。消火栓间距不大于 30 米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用 SG24/65 型室内自救式消火栓，消火栓口径为 DN65，水龙带长 25 米，水枪喷嘴为 DN19。消防给水管采用热镀锌管。

C、室外给水系统

室外供水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。

供水管网系统布置成环状，主要管径由 DN150 组成，室外设有地上式消火栓。

三、排水设计

室内排水

室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用 PVC

芯层发泡管道。

室外排水

室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。

四、消防固定灭火系统

主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时地扑灭。

另外，本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器，充装量为 6L，灭火级别为 5A，以备在火灾刚发生时使用，以避免用水灭火而导致产品损坏。

5.4.2 供电

电气工程

(1) 供电电源

本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为 5000KW。

无功功率补偿

变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV 母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。

继电保护

变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。

(2) 低压配电方式及线路敷设

根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。

(3) 照明

车间配电及照明

a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；

b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为 250—300lx；

c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换；

d、车间照明灯具采用高效节能的 LED 灯。

电能管理与节电措施

车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。

各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。

电气安全

为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳，电力线路的金属保护管等均采取接地保护。

厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于 3 欧姆。

办公区域照明灯具主要以 LED 节能灯为主，结合场所功能需要，可适

当布置一些功能效应灯。

办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。

楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。

室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。

（4）避雷及接地

本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。

避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。

（5）通讯及互连网络

建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。

（6）排风设置

车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高，也有损职工的身体健康，为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统，在厂房的墙上或屋顶位置设排风机，另外，在厂房内设置部分吊扇，以便夏季降低室内温度。

5.5 道路设计

1、设计原则

厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。

2、布置形式和宽度

厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道

6 米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。

5.6 总图运输方案

场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。

5.7 土地利用情况

5.7.1 项目用地规划选址

项目用地位于四川省内江市威远县 XX 区，该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。

5.7.2 用地规模及用地类型

- 1、用地类型：项目建设用地性质为规划性建设用地。
- 2、用地规模：本次建设项目总占地面积为 35 亩，总建筑面积为 17850.00 平方米。
- 3、土地利用现状：厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产要求。
- 4、用地指标：经审查，该项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。

项目用地指标表

序 号	技术指标名称	数量	单位
1	厂区占地面积	23333.45	m²
2	建筑计容面积	29050.00	m²
3	建构筑物占地面积	13050.00	m²

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/518063002020006120>